

深圳佰维存储科技股份有限公司

投资者关系活动记录汇总表

(2025年2月14日)

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 专场机构交流会 <input type="checkbox"/> 其他 _____	<input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观
参与单位名称及人员姓名	国调创新 李小斌、国调创新 姜中业、广州市海珠城市建设发展集团 刘鑫、广州市海珠城市建设发展集团 孟皓、青岛国信创投 王玥、青岛国信创投 苑博、中移资本 马思原、华泰资管 郑金镇、中国船舶集团投资有限公司 陈泊舟、前海中船（深圳） 张勇、前海中船（深圳） 刘斯佳、前海中船（深圳） 叶美麟、君和资本 宋礼之、君和资本 张兴泰、福建银丰创投 王炳光；湖南高新创投 贾幻；远致瑞信 谢源皓、远致瑞信 黄宇、陕西金控新时代资本 徐冠青、湖南财信 周意丰、正奇能科集团 聂瑞、正奇能科集团 王保勤；未来资产 林宏博	
会议时间	2025年2月14日 14:00-18:00	
会议地点	佰维存储惠州封测制造中心一楼会议室	
上市公司接待人员姓名	公司管理层 董办工作人员	
投资者关系活动主要内容介绍	<p>本次现场调研主要分为现场参观及交流问答环节。</p> <p>一、参观情况</p> <p>本次线下调研投资者主要参观了公司位于惠州的封测制造中心。</p> <p>二、交流环节：</p> <p>Q1. 公司智能穿戴业务规模有多大规模？产品有哪些竞争优势？</p> <p>A1: 根据公司发布的《2024年年度业绩预告》，2024年智能穿戴存储产品收入约8亿元，同比大幅增长。公司为Meta最新款AI智能眼镜Ray-Ban Meta提供ROM+RAM存储器，Ray-Ban Meta智能眼镜系列搭载高通第一代骁龙AR1平台，该平台专门针对散热限制在功耗方面进行独特设计优化，以打造轻量化的智能眼镜。除Meta外，公司还进入了Rokid、雷鸟创新、闪极等国内知名智能眼镜厂商供应链体系。公司研发封测一体化的布局，在智能可穿戴领域具有较强的竞争优势，能够在低功耗、快响应等方面进行主控芯片设计、固件算法优化的同时，通过先进封测工艺能力，助力产品的轻薄小巧。未来，公司将不断深化研发封测一体化布局，延伸公司的价值链条，增强公司的核心竞争力，为客户提供更加高效高质的存储解决方案。</p> <p>Q2. 公司有哪些产品布局能够把握AI手机、AIPC及智能可穿戴设备领域的市场机遇？</p> <p>A2: 在智能手机领域，随着AI大模型的广泛应用，为了最大程度展现端侧AI的</p>	

能力，目前已有不少手机厂商开始调整其旗舰产品的存储配置，公司有望受益于 AI 手机的发展；在产品方面，公司面向 AI 手机已推出 UFS3.1、LPDDR5/5X、uMCP 等嵌入式存储产品，并已布局 12GB、16GB 等大容量 LPDDR 产品。在 PC 领域，AIPC 基于大模型的算力需求，对搭载高容量先进制程 DRAM 产品的需求增加，同时为了有效管理 PC 上运行的 AI 数据，也会增加对 NAND 产品的需求；公司面向 AIPC 已推出 DDR5、PCIe4.0 等高性能存储产品。在智能可穿戴领域，公司 ePOP 系列产品目前已被 Google、Meta、小天才等知名企业应用于其智能手表、智能眼镜等智能穿戴设备上，其中，公司为 Ray-Ban Meta 提供 ROM+RAM 存储器芯片，是国内的主力供应商；基于公司研发封测一体化的布局，公司产品在可穿戴领域具有较强的竞争优势，公司自研主控也将进一步增强公司产品在穿戴领域的竞争力。

Q3. 请介绍一下公司开展晶圆级先进封测项目的原因及该项目技术团队背景和能力。

A3：晶圆级先进封装技术是当前半导体技术领域的重点发展方向之一，亦是 Chiplet 实现的重要基础，能够使得 IC 产品实现更大的带宽、更高的速度、更灵活的异构集成以及更低的能耗。先进存储器发展需要运用晶圆级先进封测技术，为顺应行业发展趋势，公司需要构建晶圆级先进封测能力。目前，大湾区正着力构建半导体产业链，大湾区半导体产业已具备较强的 IC 设计和晶圆制造能力。在大湾区构建晶圆级先进封测能力将有力地支持产业链发展，满足本地客户需求，提升公司市场影响力。公司已构建完整的、国际化的专业晶圆级先进封装技术、运营团队。项目负责人拥有 15 年以上国际一流半导体公司运营管理经验，曾主持建立了国内首批 12 英寸晶圆级先进封装工厂并实现稳定量产。项目核心团队具备成熟研发和量产经验，熟练掌握晶圆级先进封装核心技术。

Q4. 泰来科技作为公司的先进封测制造基地，在先进的制造测试工艺有哪些优势？

A4：公司掌握 16 层叠 Die、30~40 μm 超薄 Die、多芯片异构集成等先进封装工艺，为 NAND Flash 芯片、DRAM 芯片和 SiP 封装芯片的大规模量产提供支持。公司在 NAND Flash 和 DRAM 芯片的 ATE 测试、Burn-in 测试、SLT 测试等多个环节拥有从测试设备、测试算法到测试软件的全栈研发能力，并处于国内领先水平。通过多年的产品开发、测试、应用循环迭代，公司测试能力不断积累提升，产品综合失效率较低，具备较强竞争力。

Q5. 公司目前及未来一段时间的存货策略是怎样的？

A5：自 2024 年以来，公司采取较为中性的备货策略，以销定采。公司预计将继续保持以销定采的备货策略。

Q6. 请问公司在服务器企业级存储领域有什么产品布局？

A6：在企业级存储市场，公司着力提升市场份额与核心竞争力，力争实现与更多一线客户的深度合作。公司打造了完善的企业级存储解决方案，不仅提供多种接口、外形尺寸和容量的固态硬盘与内存条，还积极探索与 AI 高算力相契合的前沿存储技术，推出了 CXL 内存模组，助力企业级用户构筑快速、稳定、成本效益高的数据基础设施。公司企业级存储可分为 SATASSD、PCIeSSD、CXL 内存

	<p>及 RDIMM 内存条四大类产品，其中，公司企业级 SP506/516 系列 PCIe5.0SSD 荣获了存储风云榜“2024 年度企业级固态盘产品金奖”。</p> <p>Q7. 公司的产品销售的全球化战略是怎样的？</p> <p>A7：公司秉持立足中国、面向全球的发展战略。除深耕国内市场外，公司坚持贯彻全球化战略布局，在北美、拉美、印度、欧洲、中国台湾地区等地发展并打造了强有力的本地化服务、生产交付和市场营销团队。同时，公司已建立起全球经销商网络并与诸多主流销售渠道建立合作关系，目前已开拓全球客户 200 余家，覆盖全球 39 个国家和地区，在美国、巴西等 17 个国家和地区均建有经销商网络。未来，公司将借助全球化运营/交付服务网络，进一步开拓国际一流客户和各地区性市场，加强品牌形象建设，提升全球市场占有率。</p> <p>Q8. 如何看待国内半导体存储解决方案商的发展机遇？</p> <p>A8：目前，国产 DRAM 和 NAND Flash 芯片市场份额较低，发展前景较大。在中国“互联网+”、大力发展战略信息技术和不断加强先进制造业发展的战略指引下，国内信息化、数字化、智能化进程加快，用户侧的 AI、短视频、直播、游戏、社交网络等应用和制造侧的工业智能化逐渐普及，刺激存储芯片的市场需求快速增长。2014 年以来，中国成为全球最大的消费电子市场，并开始扮演全球消费电子行业驱动引擎的角色。此外，5G、物联网、数据中心等新一代信息技术在中国大规模开发及应用，也催生了我国对半导体存储器的强劲需求。随着国内存储器产业链的逐步发展和完善，以公司为代表的存储器研发封测一体化厂商也迎来了发展机遇。</p>
附件清单	无
日期	2025 年 2 月 14 日
备注	接待过程中，公司与投资者进行了充分的交流与沟通，并严格按照公司《信息披露管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，没有出现未公开重大信息披露等情况。